

マレーシアで半導体ウェハバンピング受託加工製造の設備拡充 スマートフォン向けパワー半導体用途に10億円投資

長瀬産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上島宏之、以下「長瀬産業」）は、中期経営計画「ACE 2.0」の成長ストーリーにおいて、「基盤」「注力」「育成」「改善」の4つの領域を掲げ、商社、製造、研究開発の各機能を軸に事業を展開しています。このたび、長瀬産業の子会社で、半導体及び電子部品向け製造装置の販売・半導体ウェハバンピング受託加工製造を展開する PacTech - Packaging Technologies GmbH（独・ナウエン、President：Dr. Thorsten Teutsch）が、マレーシア・ペナンに拠点を置く PacTech Asia Sdn.Bhd.（以下、PacTech Asia）に10億円の設備投資を行うことを決定しました。本投資は、注力領域である半導体分野等の製造機能強化の一環となります。

本投資は、スマートフォンや電子機器全般に使用され、半導体の高度化かつ低消費電力化への寄与が期待されるパワー半導体等のニーズの高まりをうけて同拠点内に半導体ウェハバンピング受託加工製造装置を増設するもので、新たに増設されるラインは2024年4月以降順次稼働予定です。今回の投資により従来の約1.5倍となる生産能力の向上が見込まれており、スマートフォンや電子機器全般に使用されるウェハレベルパッケージ（WLP）受託加工市場でのシェア拡大を図ります。

PacTech Asiaは無電解めっき方式のウェハレベルパッケージ（WLP）をコア技術としており、グローバルのWLP受託加工市場で世界有数のシェアを有しています。無電解めっき方式のWLPは、低コストかつバジ処理による大量生産に適していることから主にミドル・ローエンド製品向け半導体で使用され、ハイエンド向けにはより微細な加工が可能な電解めっき方式が使用されています。近年、半導体の高機能化（複合化）や3次元化が進むなか、ミドル・ローエンド向けの半導体製造工程をハイエンド向けに使用する動きが検討されており、無電解めっき方式のWLP市場が拡大することが見込まれます。

PacTech Asiaは、薬液の濃度や温度などのコントロール技術を強みとし、無電解めっき方式においても微細な加工を可能とする技術を有しています。今回の設備投資を通じ、半導体の旺盛な需要に応えてまいります。

NAGASEグループは「ものづくりの課題を素材（マテリアル）を通じて解決する企業」として、人々が安心安全で暮らせる温もりある社会の実現への貢献に取り組んでまいります。

◆本件に関するお問い合わせ先

長瀬産業株式会社 URL：<https://www.nagase.co.jp/>

<事業に関するお問い合わせ>

エレクトロニクス事業部 TEL:03-3665-3879

<報道に関するお問い合わせ>

経営管理本部 コーポレートリレーション部 PR課 TEL：080-8828-8676